

# 別表1 特定の工法や使用する資機材によってプリント配線板に含有される物質 計10物質 印

注)すべてのプリント配線板にこれらの物質が全て含有されているわけではありません。

政令 番号	CAS No	物質名(日本語)	含有について ( of )	工程	使用資機材	備考
1	25	アンチモン及びその化合物		ソルダーレジスト	シンボルマーク印刷用インク (黄色)	
				銅張積層板製造工程 (FPC)	接着剤添加剤(難燃剤)	ベースフィルムとカバーフィルムの接着剤 *一部製品のみ
				銅張積層板製造工程	紙フェノール基材(難燃剤)	*一部製品のみ
2	64	銀及びその水溶性化合物		表面処理	鉛フリーはんだ	*一部製品のみ
				銀穴埋め	銀ペースト	
				印刷	銀ペースト	
3	100	コバルト及びその化合物		金めっき	硬質金めっき	
				銅箔製造工程	銅箔(特性向上)	
4	230	鉛及びその化合物		表面処理	はんだレベラー	*鉛フリーはんだは除く
				無電解ニッケルめっき	無電解ニッケルめっき液	安定剤(0.1wt%未満)
				表面処理	はんだ	*鉛フリーはんだは除く
				はんだめっき	はんだ電極	*鉛フリーはんだは除く
5	231	7440-02-0 ニッケル		ニッケルめっき	ニッケルめっき液	
				印刷	銀ペースト	
6	232	ニッケル化合物		ニッケルめっき	ニッケルめっき液	
				スクリーン印刷	シンボルマーク印刷用インク (黄色)	
7	252	砒素及びその無機化合物		銅箔製造工程	銅箔(表面粗化)	*一部製品のみ
8	266	108-95-2 フェノール		銅張積層板製造工程 (FPC)	接着剤主成分中の不純物	銅箔とカバーフィルムの接着剤 *一部製品のみ
				印刷	カーボンインク	
				銅張積層板製造工程	基材(紙フェノール)	
9	304	ほう素及びその化合物		銅張積層板製造工程 (FPC)	接着剤の添加剤	カバーフィルム用接着剤の難燃剤用触媒 *一部製品のみ
10	310	50-00-0 ホルムアルデヒド		銅張積層板製造工程	紙フェノール基材	
				無電解銅めっき	無電解銅めっき液	